

# Conférence IMAPS - Power 2017

du 11 octobre 2017 au 13 octobre 2017

IMAPS (International Microelectronics Assembly and Packaging Society) France organise les 11 et 12 octobre 2017 la 9ème édition du Power electronics workshop.



La 9ème édition de la conférence IMAPS **Power 2017 - From nano to macro power electronics and packaging** - se déroulera les 11 et 12 octobre 2017 à Polytech' Tours.

Co-organisée par le laboratoire GREMAN (UMR 7347) et Polytech' Tours et sponsorisée par STMicroelectronics et Eolane, la conférence portera sur les **composants de puissance** et le **packaging**.

## PROGRAMME

### FIRST DAY CONFERENCE PROGRAMME (October the 11th, 2017)

- 8h30 Workshop package and badge distribution
- 9h30 Welcome: workshop programme presentation
- 10h00 SAM3 conference introduction : "Growing importance of assembly and packaging" K. Pressel, Infineon.
- 11h00 Coffee break / Table Top Exhibition
- 11h30 **Failure Analysis Session** : "CIVA, a promising simulation software for acoustic microscopy applications", P. Serre, Predictive Image.
- 12h00 Table Top Exhibition visit
- 12h30 Lunch (Buffet)
- 13h30 **Failure Analysis Session** : "Defect localization in 3D System-in-Packages based on Lock-in-Thermography and GHz-Scanning Acoustic Microscopy", F. Altmann, FWMH-CAM.
- 14h00 "Complex Package Failure Analysis Flow Enablers and Accelerators", A. Reverdy, Sector Technology.
- 14h30 "Combined preparation flow of high precision laser tool with Plasma-FIB for SiP failure", F. Felux, Infineon.
- 15h00 Coffee break / Table Top Exhibition
- 15h15 **Failure Analysis Session** : "Latest development for failure analysis - When ions meet chemistry", G. Goupil, Tescan, Orsay-Physics
- 16h00 End of session

### SECOND DAY CONFERENCE PROGRAMME (October the 12th, 2017)

- 9h00 Workshop package and badge distribution
- 9h30 Welcome: Second day workshop programme presentation
- 9h45 Keynotes: "Additive Manufacturing of Power Electronics Magnetics", Guo-Quan Lu, VirginiaTech USA
- 10h30 Coffee break / Table Top Exhibition
- 11h00 **Session Materials, Processes & Technologies** : "Investigation on Cu-Sn inter-diffusion for power semi-conductor packaging", Yousra Bettahi, STMicroelectronics Tours, France
- 11h25 "Hybrid silver sintering die-attach paste for multi-die packaging of mid-power solutions", Alexandre Val, ASE Europe, Bruxelles, Belgium
- 11h50 "Reliability analysis of Cu-Sn intermetallic joints elaborated at low temperature by transient Liquid Phase Bonding Process", Jean-Luc Diot, Composite Innovation, Pessac, France
- 12h15 Table Top Exhibition visit
- 13h00 Lunch (Buffet)
- 14h00 Keynotes: "Panel Level Packaging for Power Applications", Rolf Aschenbrenner, IZM Fraunhofer Institute, Berlin, Germany
- 14h45 Coffee break / Table Top Exhibition
- 15h15 **Session Materials, Processes & Technologies** : "Fine Pitch Solder Bumping by Printing through Dry Film Photo Resist", Gabriel Parès, CEA-Leti, Grenoble, France
- 15h40 "Bipolar Step-up Converter with MPPT for Thermal Energy Harvesting Systems", Loreto Mateu, Fraunhofer Institute, Nuremburg, Germany
- 16h05 "Shielding's effect of radiating components", Zana Kari, Greman institute, Tours, France
- 16h30 End of session

Cette édition d'exception se déroulera sur deux jours. Elle accueillera les membres de l'équipe du projet international [SAM3](#) (Enabling reliable advanced microsystems bases on MtM, SiP and 3D technologies for European core applications) labellisé EURIPIDES2 et CATRENE, en tant que **auditeurs** et **orateurs**.

Durant ces deux jours, les participants assisteront à plusieurs sessions de conférences, entrecoupées par les visites de l'espace dédié aux exposants.

**Inscriptions (jusqu'au 2 octobre 2017) et informations pratiques sur :** <http://france.imapseurope.org>

Contact : [imaps.france@imapsfrance.org](mailto:imaps.france@imapsfrance.org)



*IMAPS Power 2016*

*IMAPS est la plus grande société de packaging dédié à la microélectronique du monde. Elle soutient le développement de la recherche et le transfert de compétences au travers, notamment, l'organisation de conférences internationales. Plus d'informations sur le site web [IMAPS.France](http://IMAPS.France).*

[Télécharger le programme de la conférence \[PDF - 543Ko\]](#)